

# 電子機器2022 トータルソリューション展

6.15 Wed. → 6.17 Fri. 東京ビッグサイト 東4-6ホール+会議棟

## VIP 招待状

www.jpccashow.com

**VIP特典**  
 ■VIP専用ラウンジをご利用いただけます  
 ■VIPパスをお持ちの方は、電子機器トータルソリューション展、全基調講演が無料で聴講できます  
 一般聴講料：会員 10,000円、非会員 20,000円 / 1セッション (税込)

VIP No. 220615

**開催概要**

JPCA 2022 Show 第51回 国際電子回路産業展  
 JIEP マクロエレクトロニクス 第39回 最先端実装技術・パッケージング展  
 JISSO PROTEC 2022 第23回 実装プロセス/ロジック展  
 SDGs電子デバイス展  
 WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展  
 JEP/TEP Show JEP 全国電子部品流通協会 主催 一般社団法人日本電子部品工業会

E-Textile Smart Sensing InterOpto LED JAPAN Imaging Japan Edge Computing

会期：2022年6月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00  
 会場：東京ビッグサイト 東4-6ホール+会議棟  
 入場料：1,000円(税込) ※招待券持参者及びWEB登録者無料  
 本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会  
 運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

**基調講演 プログラム** [有料] [VIP無料] 来場事前登録より、聴講申込みください。 展示ホール A会場

聴講料：会員\*10,000円、非会員 20,000円 / 1セッション (聴講料は税込です) ※JPCA 会員 / JIEP 正会員 / 賛助会員 / JARA 正会員 / 賛助法人会員 / JEP / TEP 正会員

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
<b>SDGs電子デバイス</b> 3000兆円投資のSDGs革命、メタバースが電子デバイスに大インパクト 株式会社タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉	<b>E-Textile / ウェアラブル</b> 新たな実装技術で創るフレキシブルデバイス「インフォームド・フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス (IFHE)」 東北大学 大学院工学研究科 機械機能創成専攻 准教授 福島 聖史	<b>医療 / FLEX基板 (脳波・アルツハイマー)</b> 伸縮自在なエレクトロニクスで創る「脳波AI解析ツール」 大阪大学 産業科学研究所 教授 関谷 毅
<b>IoTスマートシティ</b> 都市間連携でデータを共有するスマートシティの未来～MCSCCの活動紹介～ (一社)サイバースマートシティ創造協議会 代表理事 豊崎 雅久	<b>自動車</b> カーボンニュートラルに向けた自動車の電動化の最新動向 技術研究組合 FC-Cubic 専務理事 大仲 英巳	<b>半導体生産線</b> 東京大学の産学連携最前線～半導体強化およびDX推進～ 東京大学 工学部長、大学院工学系研究科長 染谷 隆夫
<b>パワーエレ / 実装</b> パワー半導体の将来展望 パワー半導体を支える日本の未来像 三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 所長 岩上 徹	<b>スマホ / 内蔵カメラ</b> すべてがつながったインテリジェントな世界へ 株式会社エヌエス 代表取締役 張 松樹	<b>川崎重工グループの水素サプライチェーン構築の取り組み (仮)</b> 川崎重工株式会社 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦

**ものづくり系YouTuber ものづくり太郎氏によるトークイベント開催決定!** [無料] [事前登録不要] 展示ホール A会場

【ものづくり太郎とは?】チャンネル登録数14万件を誇るYouTuber「ものづくり太郎チャンネル」にて検索ください。

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
	14:30-15:15	
		「ものづくり太郎、日本の電子回路産業を斬る!」(仮)

**JIEP 最先端実装技術シンポジウム** [有料] [要事前登録] 会議棟6階 605+606会議室<A会場>及び607+608会議室<B会場>

※聴講料は会員区分によって異なります。全額・聴講申込方法はHPよりご確認ください。 www.jpccashow.com/show2022/

Time	A会場		B会場	
	Title	15A-1 9:50-12:30	Title	15B-1 10:30-12:15
9:50-10:40	15A-1 高周波に対応する銅配線形成技術 -新シート層を用いた「平滑面」への銅配線の形成	富士川 直 DIC 株式会社 E-2プロジェクト 技術統括マネージャー	15B-1 次世代ノードの鍵を握る3D集積技術の進化と応用に向けた取り組み	井上 史大 横濱国立大学 准教授
10:40-11:35	15A-2 BSGを見据えたフッ素系材料の技術・開発動向	細田 朋也 AGC 株式会社 化学品カンパニー 応用商品開発部 複合材料開発室長	15B-2 最先端ダイ / ウェアレバブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 株式会社エーエスエス 代表取締役
11:35-12:30	15A-3 高周波対応・特殊用途のFPC/Semi Flex PWBの採用事例	上田 弘孝 セミコンサル 代表	15B-3 Overview and Initiatives of TSMC Japan 3DIC R&D Center (仮)	市川 公也 TSMCジャパン 3DIC 研究開発センター 代表取締役
13:35-14:30	15A-2 次世代情報処理 (AI, IoT等、量子コンピューター) -SDGsも背景にある? 座長:土門 孝彰, 貴藤 晋之	山道 新太郎 日本アイ・ピー・エム 代表	15B-4 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
13:35-14:30	15A-21 量子コンピューターの開発と導入	山道 新太郎 日本アイ・ピー・エム 代表	15B-5 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
14:30-15:25	15A-2 Quantum Transformation 量子コンピュータによる社会実装最前線	寺部 雅能 住友商事株式会社 Quantum Transformationプロジェクト プロジェクト代表	15B-6 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
15:25-16:20	15A-3 量子コンピューター開発におけるシリコン集積化技術の役割	森 貴洋 産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 主任研究員	15B-7 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
9:45-10:40	16A-1 5G・6G通信端末市場と実装技術動向	座長:藤川 幸司, 越後 福嗣	16B-1 (仮) 日本半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
10:40-11:35	16A-2 5Gスマートフォンの見る半導体パッケージと今後のビジネスチャンス (仮)	清水 洋二 株式会社 テクノカネ	16B-2 パッケージ市場での日本の強みと今後のビジネスチャンス (仮)	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
11:35-12:30	16A-3 (仮) 次世代パッケージ FOLP の特徴と適用市場	鈴木 健史 アイ電子株式会社 第1技術本部 FOLP 事業部 部長代理	16B-3 半導体産業の変遷と今後の展開 -海外から学ぶシリコン集積のシナリオ	湯田 健二 国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長
13:35-14:30	16A-2 CASEに向けた車載機器実装技術の最新動向	座長:三宅 敏広, 油田 浩樹	16B-4 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
14:30-15:25	16A-21 日中激変の分解から読み取る2025年のEV像とそこに求められる(パワ)エレクトロニクス実装技術最前線	山本 憲一 名古屋大学 未来材料・システム研究部 教授	16B-5 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
15:25-16:20	16A-22 ワイドギャップ半導体向けパワー・エレクトロニクス技術開発	杉本 昭雄 大分大学 未来材料・システム研究部 部長	16B-6 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
9:45-10:40	17A-1 新たな配線・実装がもたらすスマート材料最前線 (仮)	座長:本多 進, 小岩 一郎	17B-1 e-Axleと電池	座長:三宅 敏広, 土門 孝彰
10:40-11:35	17A-2 女子大工学部で取り組むフレキシブルウェアラブルなシステムの研究	前田 壽司 東京紡績 総合研究所 主幹	17B-2 半導体産業のこれからの3D-IC実装技術の現状と課題、アカデミアからの提案	福島 聖史 東北大学 大学院工学研究科 機械機能創成専攻 准教授
11:05-11:55	17A-3 e-テキスタイル、導電糸とは? (仮)	菅山 秀樹 福井工業技術センター 新産業創出研究部 ウェアラブル技術研究グループ 主任研究員	17B-3 実装技術の変遷と今後の展望	晴 孝志 東レエンジニアリング株式会社 第一事業部開発部 チームリーダー
11:55-12:30	17A-4 衣服ウェアラブルデバイスによるバイタルセンシング	前田 壽司 東京紡績 総合研究所 主幹	17B-4 企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム (JOINT2)	清倉 一 昭和電気マテリアルズ株式会社 パッケージングソリューションセンター 主任研究員
13:35-14:30	17A-21 オートバイロボット型統合ECUに見る実装技術	清水 洋二 株式会社 テクノカネ	17B-5 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
14:30-15:25	17A-22 車載E/E-アーキテクチャの進化に向けたECU実装構造とプリント配線板技術	戸田 光昭 株式会社 エーエスエス 先行開発マーケティング部 部長	17B-6 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役
15:25-16:20	17A-23 微細化するピッドアップ基板マイクロピアの信頼性問題	菅沼 克昭 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 特任教授・所長	17B-7 最新半導体産業の復興なんて何? 湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役	湯之上 隆 株式会社 湯之上 隆 代表取締役

**ダントツのものづくりセミナー** [無料] [事前登録不要] 展示ホール B会場

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
<b>【特別講演1】</b> 飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO 岸良 裕司	<b>【特別講演2】</b> 月曜日を楽しみたい会社には? ~全体最適のマネジメント理論TOCとは~ ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO 岸良 裕司	<b>【特別講演3】</b> 月曜日を楽しみたい会社には? ~全体最適のマネジメント理論TOCとは~ ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO 岸良 裕司
<b>【特別講演4】</b> 品質経営の取り組み方 (シックスシグマ品質) アリス Lin Liu (劉) マスターブラックベルト	<b>【特別講演5】</b> JPCAものづくり大賞受賞改善取り組み 事例報告 山本 治彦 JPCA 副会長 / JPCAものづくりアカデミー 校長 EESMAP 研究会代表幹事	<b>【特別講演6】</b> JPCAものづくり大賞受賞改善取り組み 事例報告 山本 治彦 JPCA 副会長 / JPCAものづくりアカデミー 校長 EESMAP 研究会代表幹事
<b>【特別講演7】</b> いま振り返るデミング博士の魂の教え ~デミング博士著作Out of The Crisis初日本語版刊行記念~ ビーキューブ株式会社 代表取締役社長 成沢 俊子	<b>【特別講演8】</b> JPCAものづくり大賞受賞改善取り組み 事例報告 山本 治彦 JPCA 副会長 / JPCAものづくりアカデミー 校長 EESMAP 研究会代表幹事	<b>【特別講演9】</b> JPCAものづくり大賞受賞改善取り組み 事例報告 山本 治彦 JPCA 副会長 / JPCAものづくりアカデミー 校長 EESMAP 研究会代表幹事

**来場のご案内**  
 電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願い致します。  
 本招待状をお持ちいただいただけでは入場できませんのでご注意ください。

**STEP.1** 公式ホームページより来場登録へお進みください

**STEP.2** ご登録いただいたメールアドレス宛に、「来場者証」のPDFが添付された登録完了メールが届きます。登録完了メールが届かない場合は事務局までお問合せください。

**STEP.3** 展示会当日、登録完了メールに添付されている「来場者証」をプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。パスケースをピックアップ頂き、来場者証を中に入れ、会場入り口にてバーコードをご提示ください。

最新情報はHPをご覧ください

**来場者参加企画：ブースコンテスト**  
 来場者参加型企画として昨年実施いたしましたブースコンテストを今年も開催【ナイスデザイン賞】・【ベスト展示賞】・【特別賞】に値する出展ブースを皆様の投票で決定します。投票していただいた皆様へは品物を進呈いたします。ぜひご参加ください。

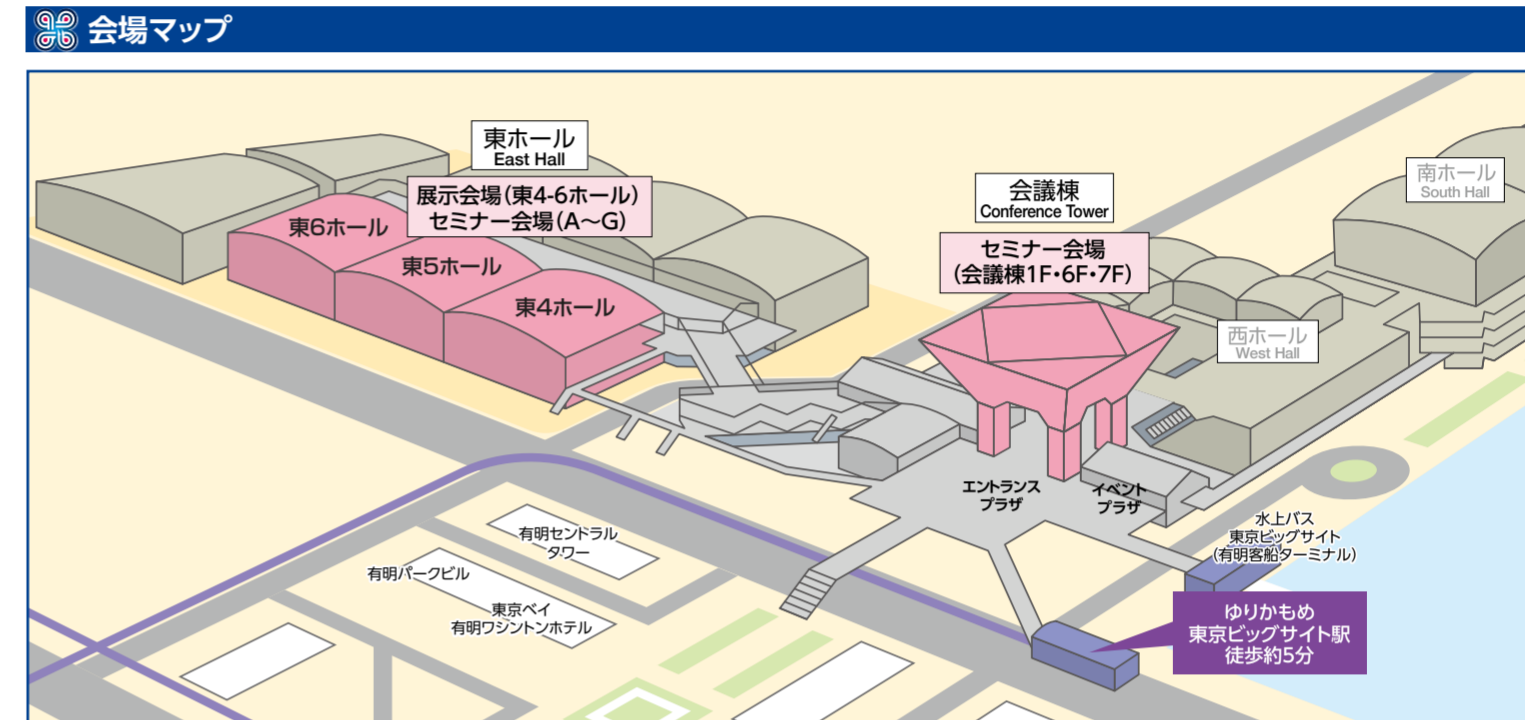
**来場者参加企画：スタンプラリー**  
 電子機器トータルソリューション展展示ブース企業ブースを全社訪問するとオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーを開催します! 台紙は会場にてお配りいたしますので、ぜひブース訪問してください。

**ヨロズ相談室** [無料] 展示ホール内  
 来場者の皆様からの技術的な相談、インターネットでは聞けない疑問等にJPCAコンサルタントがお答えします。電子回路(基板・実装・材料)、専門加工、製造装置、センサ等の技術に関すること、活用方法がわからない方、ヨロズ相談室までぜひご相談ください。

本展では、コロナ対策を徹底の上、開催いたします。  
 ご来場の皆様には感染症対策を徹底いただき、ご来場予定当日に体調不良の場合はご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

マスクの着用 検温の実施 ソーシャルディスタンス 手指消毒 咳エチケット 大きな声で会話

訪問先の記録 換気の実施 こまめな手洗い 分散来場 余裕を持ったレイアウト 三密の回避



**JARA 創立50周年記念セミナー** [無料] 展示会へご来場の方はどなたでも聴講いただけます。事前の聴講申込が必要です。 会議棟1階 101会議室

聴講のお申込みはJISSO PROTECのHPからお願いします https://www.jissoprotec.jp

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
<b>スマート化(工場、製造ライン、物流)</b> 安川電機が進めるDXもものづくりの変化への対応 ~YDX (YASKAWAデジタルトランスフォーメーション)と「Mechatronics (アイキューブ メカトロニクス)」の活動事例~ 小笠原 清 株式会社 安川電機 代表取締役会長兼社長	<b>実装技術の最新動向 (実装設備、接合材料、電子部品)</b> 2022年度版JEITA実装技術ロードマップの紹介 ~実装設備を中心に~ 前田 憲 株式会社 パナソニック コネクティブ プロセスオートメーション事業部 JEITA 実装技術ロードマップ専門委員会 実装設備WG 主査	<b>SMT業界をとりまく世界的変化 (DX・IoT、新エネルギー)</b> 三菱電機のデジタルマニュファクチャリング ~技術革新によるサステナブルな社会の実現~ 橋本 清 株式会社 三菱電機 FAシステム事業部 役員技監
<b>企業の垣根を越えた取組 SMTのスマート化を推進する新しいグローバル通信標準</b> SEMI Flow Manufacturing (FM) Forum スマートロジスティクス ~Logisticsから LOGISTEEDへ~ 長尾 清志 株式会社 日立物流 執行役員 営業統括部長 兼 ロジスティクスソリューション開発部長 兼 輸送事業推進部長	<b>CASE時代に求められる接合材料・実装技術</b> CASE時代に求められる接合材料・実装技術 神谷 有弘 株式会社 JEITA 実装技術ロードマップ専門委員会 委員 JIEP 部品内蔵技術委員会 委員	<b>中国EVシフトの現在地</b> 中国EVシフトの現在地 湯田 健二 上海工程技术大学 客員教授
<b>電子部品の最新技術動向</b> JEITA 電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会 主査 加藤 智文 JEITA 電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会 メンバー 谷本 雅樹 JEITA 電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会 メンバー		

**PROTECセミナー** [無料] 会議棟7階 703会議室

聴講申込方法はJISSO PROTECのHPよりご確認ください https://www.jissoprotec.jp

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
<b>実装・アセンブリに貢献するMUSASHIのディスペンサ技術</b> 大岡 正典 株式会社 武蔵エンジニアリング マーケティング戦略本部 統括課長	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー
<b>5Gがもたらす実装課題に対応するものづくり最前線</b> 武野 祐丸 株式会社 FUJII 営業技術部 第2営業技術課 課長	<b>進化する知能で実現するAutonomous Factory</b> 高橋 道明 パナソニック コネクティブ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発統括部 システムソリューション開発部 開発4課 課長	<b>進化する知能で実現するAutonomous Factory</b> 高橋 道明 パナソニック コネクティブ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発統括部 システムソリューション開発部 開発4課 課長
<b>前後工程の自動化による効率化と最新SMTソリューションのご提案</b> 加藤 大輔 株式会社 FUJII 第一ソフト技術部 部長	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー
<b>FSF2.0 進化するスマートファクトリー</b> 加藤 大輔 株式会社 FUJII 第一ソフト技術部 部長	<b>SMT後工程の自動化</b> 石川 信幸 株式会社 FUJII 第四営業部 第2営業課 課長	<b>SMT後工程の自動化</b> 石川 信幸 株式会社 FUJII 第四営業部 第2営業課 課長
<b>進化する知能で実現するAutonomous Factory</b> 高橋 道明 パナソニック コネクティブ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発統括部 システムソリューション開発部 開発4課 課長	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー	<b>実務で役立つフリーはんだ印刷技術2022</b> 川井 健三 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 国内営業部 SPグループ グループリーダー
<b>~実装変動の知見から生み出される~ 最先端検査技術と品質システム</b> 杉山 優希 オムロン株式会社		

**熱関連セミナー** [無料] [事前登録不要] 会議棟6階 610会議室

調整中

6月17日(金)
<b>調整中</b> 13:00-14:00 鈴木 康一 山口東京理科大学 名誉教授 島山 友行 富山県立大学 准教授

**製品安全セミナー** [無料] [事前登録不要] 会議棟6階 610会議室

13:30-14:30 製品安全セミナー 榎場 正男 株式会社 ヤマハ 代表取締役

**ロードマップセミナー** [有料] [要事前登録] 会議棟7階 701+702会議室

6月16日(木)  
 13:00-13:50 最新半導体パッケージ技術動向 宇都宮 久徳 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社  
 14:00-14:30 最新半導体市場動向 山本 義雄 みずほ証券株式会社  
 14:30-15:00 最新機能集積配線板技術動向 横内 貴志株式会社  
 15:10-16:00 最新高速通信機器システム 西尾 俊彦 株式会社 SBRテクノロジー  
 16:10-17:00 最新高速通信機器用プリント基板 飯長 裕 OKIサーキットテクノロジー株式会社

**ぷりんとはんじゅくセミナー** [無料] [事前登録不要] 会議棟6階 609会議室

11:00-12:00 プリント配線板全般の基礎「ぷりんとはんじゅくI」をもとに解説 榎場 正男 株式会社 ヤマハ 代表取締役  
 13:00-14:00 プリント配線板設計の基礎「ぷりんとはんじゅくII」をもとに解説 田中 弘文  
 14:30-15:30 フレキシブル配線板の基礎「ぷりんとはんじゅくIII」をもとに解説 宮崎 博明 MFインフォメーション株式会社 代表取締役

**日本の電子回路産業発行報告会** [無料] [事前登録不要] 会議棟6階 610会議室

6月16日(木)  
 10:15-11:15 電子回路産業の現状と将来展望について 藤原 徹 (一社)日本電子回路工業会 調査担当

**PWBコンサルタントスキルアップセミナー** [無料] [要事前登録] 会議棟6階 609会議室

6月17日(金)  
 15:00-16:45 PWBコンサルタントスキルアップセミナー [有料] PWBコンサルタント、PWBインストラクター1級・準1級資格保有者の方のみ ※別途事前申込が必要です 安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

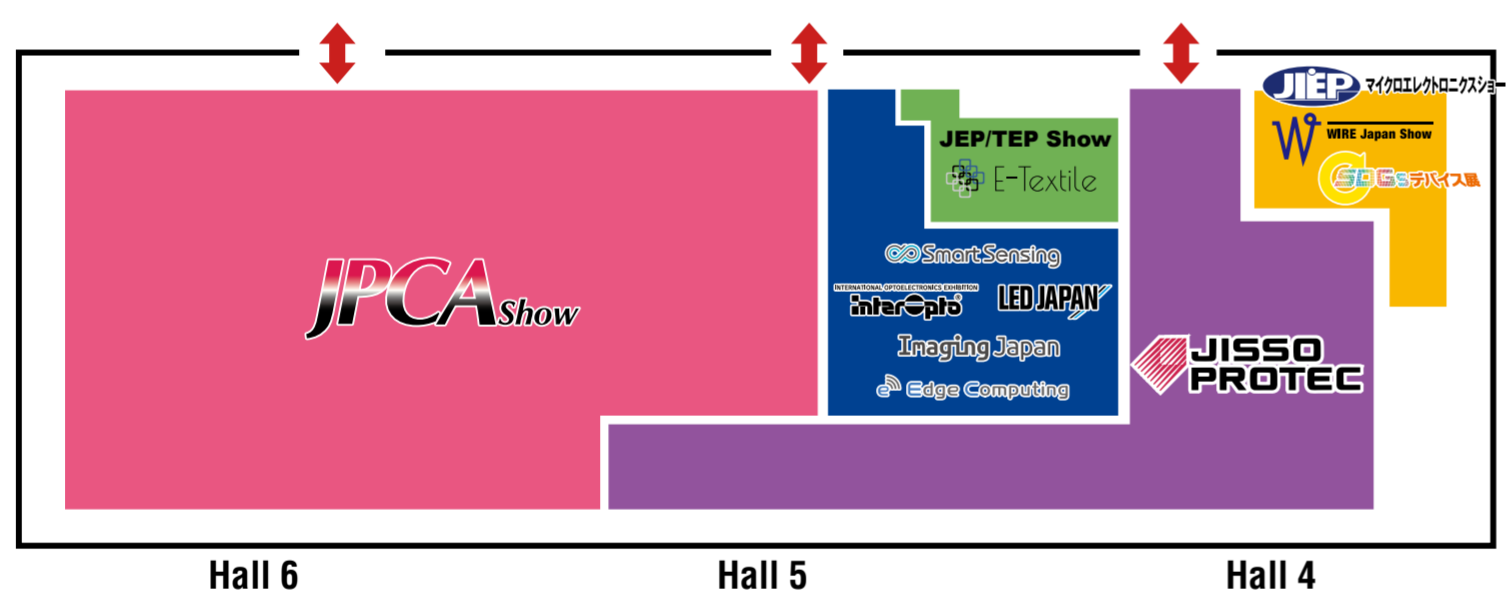
※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早目の受付にご協力をお願いいたします。

	展示ホール E会場 NPIセミナー会場①	展示ホール F会場 NPIセミナー会場②
6月15日(水)	13:35-13:55 高周波化対応次世代BTレジン材料の紹介 三菱ガス化学株式会社	ますます重要になっていく基板クリーナーにおける静電制御 株式会社ブルックスジャパン
	14:15-14:35 シミュレーションとAIでプリント基板設計に革命 株式会社オンテック	SLM(液晶空間光変調器)とそのアプリケーション応用: 米国MDラークオプティクス社製SLMの最新動向とアプリケーション事例につきご紹介いたします。 フォトテックニカ株式会社
	14:55-15:15 世界最先端のUVセンサ技術とその応用 (監修: sglux GmbH) 株式会社アイ・アール・システム	一括運搬実装に対応するはんだ印刷マスク用レーザー加工技術と微細加工分野への応用 株式会社ブルックスジャパン
	15:35-15:55 高性能有機半導体技術を利用したフィルムセンサが実現するスマート社会 株式会社バククリスタル	
	10:55-11:15 あらゆる測定器を同時監視!ソフトウェア開発歴24年の実績と実力で挑む、IoT技術の新たな付加価値。 株式会社ソフトエージェンシー	日立ハイテクサイエンスが提供するプリント基板の評価・分析技術紹介 日立ハイテクサイエンス
6月16日(木)	11:35-11:55 Beyond 5G向け めっきプロセスのご提案 株式会社JCU	部品実装工程におけるCAD/CAMデータを活用したダイナミック実装ソリューション ダイナミック株式会社
	12:15-12:35 レーザアブレーション加工機によるポリイミド、フッ素樹脂フィルムの高品質加工 株式会社澁谷工業	"InShop" 装置データ集計・検証システム" 新バージョンとロードマップのご紹介 日本オルボテック株式会社
	12:55-13:15 高弾性・低熱膨張プリント配線板用材料MCL-E-795Gのご紹介 昭和電工マテリアルズ株式会社	
	13:35-13:55 プリントドデバイス開発事例紹介 株式会社ダイヤセル	注目の出展者プレゼン(仮) interOpto出展者
	14:15-14:35 薄膜密着強度測定機 Romulus 紹介 フォトテックニカ株式会社	注目の出展者プレゼン(仮) interOpto出展者
14:55-15:15 半世紀で培った不織布製法で○○○が可能になる研磨ホール 株式会社金井重要工業	薄膜〜厚膜、全面〜部分塗布 INK JET 技術のご紹介 株式会社石井表記	
15:35-15:55 ZEISS非破壊3D高分解能イメージング X線顕微鏡のご紹介_x00B_[Electronics編] 株式会社カールツァイス	高品質・量産対応の革新的ロール to ロール式DI機 "Infinitum" とUVレーザードリル機 "Apeiron" のご紹介 日本オルボテック株式会社	
6月17日(金)	10:55-11:15 液晶光記向膜を用いた幾何学位相素子形成とその応用 国立大学法人 長岡技術科学大学 電磁波・光波制御研究グループ	水平型ロール to ロールめっき装置対応 高ビアフリタリング硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 水平型ロール to ロールめっき装置の課題を克服 良好なピアフリタリング性を発揮する硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 株式会社奥野製薬工業
	11:35-11:55 分光と言えば HORIBA ~OEMグレーティング&分光器のカスタマイズ事例~ 株式会社堀場製作所	
	12:15-12:35 ガラス基板への無電解銅めっきプロセス「PLOPXプロセス」 株式会社奥野製薬工業	
	12:55-13:15 ドイツTier 1が認めたLPKF PWBレーザーカット(デバネリング)テクノロジー 株式会社LPKF Laser&Electronics	日立ハイテクサイエンスが提供するプリント基板の評価・分析技術紹介 日立ハイテクサイエンス
	13:35-13:55 シミュレーションとAIでプリント基板設計に革命 株式会社オンテック	水平型ロール to ロールめっき装置対応 高ビアフリタリング硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 水平型ロール to ロールめっき装置の課題を克服 良好なピアフリタリング性を発揮する硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 株式会社奥野製薬工業
14:15-14:35 Zeiss非破壊3D高分解能イメージング X線顕微鏡のご紹介 [Electronics編] 株式会社カールツァイス	2次元FTIR分光装置の応用 株式会社日進機械	
14:55-15:15 「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄によるLTspiceセミナー 株式会社三共社	その不具合、樹脂が原因では?温度・湿度コントロール下での材料分析による樹脂特性の理解 ティー・エイ・インストルメント・ジャパン株式会社	
15:35-15:55 「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄によるLTspiceセミナー 株式会社三共社		
16:15-16:35 「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄によるLTspiceセミナー 株式会社三共社		

2022年度 OITDAセミナー「サイバー・フィジカル社会の実現に向けた光技術」 **無料** **要事前登録** 会議棟1階 102会議室

6月15日(水)	
10:25-10:30 主催者挨拶	小谷 泰久 (一財)光産業技術振興協会 副理事長 兼 専務理事
10:30-11:15 ダイナミックイメージコントロールの新展開	奥 寛雅 国立大学法人 群馬大学 情報学部 教授
11:15-12:00 人と機械が協調する社会の実現に向けた画像センシング技術	木下 航一 オムロン株式会社 技術・知財本部 アドバンステクノロジーセンター アドバンステクノロジー開発部 技術専門職
12:00-13:00 (昼食休憩)	
13:00-13:45 人に優しい裸眼3Dディスプレイと遠隔コミュニケーションへの応用	高田 英明 国立大学法人 長崎大学 情報データ科学部 教授
13:45-14:30 メタバースとVR技術がもたらす社会変化	岩城 進之介 株式会社バーチャルキャスト 取締役CTO

展示ホール内ゾーニング(2022年4月13日(水)現在)



Keynote Speech		企業プレゼンテーション	
11:25-12:15	「変える力」と「つなぐ力」でIoT実装に革命を 平田 昌則 コネクテックジャパン株式会社 代表取締役 CEO	6月16日(木) 14:30-15:10 多品種少量時代にはビジネスモデルで戦う「半導体実装開発に付加価値あり」 安藤 守 コネクテックジャパン株式会社 営業開発部長 取締役	
	6月16日(木) 10:15-11:05 バーチャルエコノミー拡大に向けたスマートセンシング 持丸 正明 (国研)産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長		6月17日(金) 15:30-16:10 「世界ロボットビジネス大賞」発行記念セミナー 日本のロボットビジネスの「価値筋」 小林 賢一 NPO法人ロボット普及促進センター 理事長 株式会社ロボティメディア 代表取締役

JIEPアカデミックプラザ **無料** **事前登録不要** 展示ホール G会場

6月16日(木)		6月17日(金)	
13:00-13:25 昇温耐熱分析装置(TDS)によるめっき膜や複合材料の分析 関東学院大学 / 電子科学科	負の透磁率材料を用いた伝送線路の表皮効果損失抑制に対する異方性磁界の影響 長野工業高等専門学校		
13:25-13:50 塩化カルシウム濃厚水溶液を用いた電気めっき法によるモリブデン薄膜の作製 関東学院大学大学院 / フォトテックニカ	ワイヤグリッド付きITO透明導電膜で形成するマイクロストリップ線路の伝送特性の検討 東京工芸大学		
13:50-14:15 有機溶媒中におけるアルミニウム電析めっきとスカンジウム塩化物量添加効果 関東学院大学大学院 / 沖エンジニアリング株式会社	腕部に配置する通信用ウェアラブルバイラルコイルの変形に対する伝送特性の検討 東京工芸大学		
14:15-14:40 銅系導電性ペーストの材料開発の確立を目指した界面化学現象と電気伝導特性発達挙動の解析 群馬大学	コイルを用いた血管の膨張・収縮センサによる心拍検出の検討 東京工芸大学大学院		
14:40-15:05 インモールド・エレクトロニクスへの応用を目指したストレッチャブル印刷記録の立体成形中の電気伝導特性制御 群馬大学大学院	胴体表面に配置されたウェアラブル電極を用いる人体通信の伝送特性の検討 東京工芸大学		
15:05-15:20 休憩			
15:20-15:45 高速度ビデオモニタの診断に基づくCuダイレクトレーザーバイアホール加工複数パルス照射の最適化 同志社大学大学院	経皮エネルギー伝送用コイルの円筒曲面変形に対する伝送特性の検討 東京工芸大学大学院		
15:45-16:10 マイクロドリル工具のカタログマイニングにおけるファジクラスタリングの有用性についての検討 同志社大学 / 岡山大学	4周波遮断帯域を有するUWB用半円台形不平衡ダイポールアンテナ 東京工芸大学		
16:10-16:35 Beyond-MHzスイッチング電源用プレーナ型EMIフィルタの開発 信州大学	遅延故障検査容易化!バウダリスキャンにおける観測対象判別回路による検査時間短縮 徳島大学大学院		
16:35-17:00 GHz帯用広帯域左手系疑似伝送線路型薄膜コンモンドフィルタの開発 信州大学 / 長野工業高等専門学校			

テラヘルツテクノロジーフォーラム **無料** **要事前登録** 第14回テラヘルツビジネスセミナー(14th THz-biz) 展示ホール C会場

6月15日(水)		3D-MIDパピリオンセミナー <b>無料</b> 展示ホール D会場	
13:00-15:30 調整中		10:30-11:00 「共同公演」MID設計〜レジスト〜自動実装 北郷 和英 大英エレクトロニクス株式会社	6月15日(水) 11:20-11:50 MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事

All about Photonics主催者セミナー **無料** **要事前登録** 光半導体最新セミナー 展示ホール C会場

6月16日(木)		6月17日(金)	
12:45-13:10 LD/LEDによる偏光を利用した画像計測・分光計測技術の開発 江本 顕雄 国立大学法人 徳島大学 ポストLEDフォトリソ研究所 特任講師	触媒失活材料を用いた新規MID技術とその応用 浅見 明子 マクセル株式会社		
13:15-13:40 新しい応用分野を切り拓く産業用LEDの紹介と新たな用途展開の可能性について(仮) Luminus Devices / 丸文株式会社	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事		
13:45-14:10 調整中	エビナ電化工業株式のLDS事業の取り組み 秋山 賢二 エビナ電化工業株式会社 技術営業部 係長		
	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事		
	3D-MIDのためのエレメカ協調設計環境 松澤 浩彦 株式会社 技術本部EL開発部 シニア・パートナー		

応用物理学会フォトリソ分科会ミニセミナー **無料** **事前登録不要** 展示ホール C会場

6月17日(金)		JEP/TEPセミナー <b>無料</b> 展示ホール D会場	
13:00-13:15 はじめに:「フォトリソ分科会の紹介」	6月16日(木) 11:20-11:50 製造現場・社会インフラの課題を解決するAIソリューション 中捨 隆弘 東亜無線電機株式会社 開発営業部 次長		
13:15-13:50 高感度環境分光計の進展 ~温室効果ガスから自動車排ガスまで~(仮) 戸野倉 賢一 国立大学法人 東京大学 教授	E-Textile Initiativeセミナー <b>無料</b> <b>事前登録不要</b> 展示ホール D会場		
13:50-14:25 有機半導体界面を舞台にした高効率光エネルギー変換(仮) 伊澤 誠一郎 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教	6月17日(金) 14:00-16:00 調整中		
14:25-15:00 プラスチックリサイクルに貢献する分光技術(仮) 遠藤 利久 浜松フォトリソ株式会社			

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。  
表彰式日時・会場についてはHPをご確認ください

半導体オプ・ザ・イヤーズ2022  
受賞製品・技術発表  
6月15日(水) 14:00~17:00 (受付開始13:30~)  
於・会議棟6階 610会議室

出展者一覧 2022年4月13日(水)現在 (展示会別・50音順)

- |   |  |  |   |   |  |   |  |
|---|--|--|---|---|--|---|--|
| <p><b>スポンサー企業</b></p> <p><b>プラチナ</b><br/>メテコ</p> <p><b>ゴールド</b><br/>アトテックジャパン<br/>イー・エス・アイ・ジャパン<br/>FICT<br/>ダイナトロン<br/>太陽インキ製造<br/>日本オルボテック<br/>マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン<br/>メック</p> <p><b>シルバー</b><br/>京写<br/>松和産業</p> <p><b>ブロンズ</b><br/>ニッカン工業</p> <p><b>JPCA Show</b><br/>プリント配線板技術展<br/>アドテックエンジニアリング<br/>アトテックジャパン<br/>アポロ精工<br/>アルテエンジニアリング<br/>イー・エス・アイ・ジャパン<br/>ECI JAPAN<br/>石井表記<br/>石原ケミカル<br/>イシカワテクノファブリクス<br/>伊原電子工業<br/>インスベック<br/>上村工業<br/>エト工業<br/>FICT<br/>エムシーケー<br/>LPKF Laser&amp;Electronics<br/>オーク製作所<br/>大船企業日本<br/>オカダジーエージェイ<br/>奥野製薬工業<br/>オンテック</p> | <p>科学情報出版<br/>金井重要工業<br/>北川精機<br/>協栄プリント技研<br/>京写<br/>熊本県庁<br/>クラボウ<br/>ケミトロン<br/>ケンマージャパン<br/>サーマプレジジョン<br/>相模ビーシーアイ<br/>サクラクレパス<br/>三晃技研工業<br/>J-RAS<br/>JCU<br/>四会富士電子科技股份有限公司<br/>四国化成工業<br/>澁谷工業<br/>JADASON Enterprises<br/>松和産業<br/>昭和電工マテリアルズ<br/>シライ電子工業<br/>伸光製作所<br/>深川市ニューセス実業<br/>ステラ・コーポレーション<br/>ソマール<br/>ダイナトロン<br/>大日光・エンジニアリング<br/>太陽インキ製造<br/>ダイワ<br/>ダイワ工業<br/>タカノ<br/>三恵技研工業<br/>図研<br/>角田プラザ製作所<br/>テスプロ<br/>電子回路企業年金基金<br/>東京マシン・アンド・ツール<br/>東洋銅板<br/>東洋紡<br/>ニッカン工業<br/>日刊工業新聞社<br/>日放電子<br/>日本アグファマテリアルズ<br/>日本エバレット・チャールス<br/>日本オルボテック</p> | <p>日本テルベン化学<br/>日本電産リード<br/>日本電子回路工業会 (JPCA)<br/>野田スクリーン<br/>ハイロックス<br/>伯東<br/>PAN-TEC<br/>ピアマニクス<br/>日立ハイテクサイエンス<br/>HWAJN TRADING<br/>フィッシャー・インストルメンツ<br/>福田金属箔粉工業<br/>フジブリグループ<br/>藤森工業<br/>ブルックスジャパン<br/>ベアック<br/>マイクロクラフト<br/>マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン<br/>マコー<br/>三菱ガス化学<br/>三菱電機<br/>メイコー<br/>名東電産<br/>メック<br/>モロニクス<br/>ユニオン ツール<br/>レヨーン Japan<br/>Loggers Japan</p> <p><b>3D-MIDパピリオン</b><br/>エビナ電化工業<br/>三恵技研工業<br/>図研<br/>大英エレクトロニクス<br/>太陽インキ製造<br/>日本MID協会<br/>マクセル</p> | <p><b>半導体パッケージング・部品内蔵技術展</b><br/>ウシオ電機<br/>AJ<br/>大阪ソーダ<br/>清川メッキ工業<br/>内藤電誠工業<br/>長瀬産業<br/>日本電気硝子<br/>日本ミクロン</p> <p><b>フレキシブルプリント配線板製品出展エリア</b><br/>沖電線<br/>デンカ<br/>八光電子工業<br/>山下マテリアル<br/>ユアサシステム機器</p> <p><b>機器・半導体受託生産システム展</b><br/>アソビクス<br/>富士電子<br/>ヤマキ電気</p> <p><b>マイクロエレクトロニクスショー</b><br/>Addison Clear Wave Coating<br/>エレクトロニクス実装学会 (JIEP)<br/>ダイセル<br/>和光電気</p> <p><b>eX-tech</b><br/>秋田化学工業<br/>アテネ<br/>アンドールシステムサポート<br/>イープロニクス<br/>エスベック<br/>大阪有機化学工業<br/>Shimada Appli<br/>ティー・エイ・インストルメント・ジャパン<br/>日刊産業<br/>プラズマイオンアシスト<br/>堀内電機製作所</p> | <p><b>アカデミックプラザ</b><br/>愛媛大学大学院 理工学研究科<br/>大阪産業技術研究所<br/>野田スクリーン<br/>関東学院大学大学院<br/>関東学院大学 理工学部 小岩研究室<br/>京都大学<br/>群馬大学<br/>信州大学 工学部 電子情報システム工学科<br/>先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室<br/>東海大学<br/>東京工芸大学<br/>徳島大学大学院 社会産業理工学研究部<br/>長野工業高等専門学校<br/>日本大学<br/>山形大学 YU-FIC</p> <p><b>JISSO PROTEC</b><br/>アコム工業<br/>アルファエレクトロニクス<br/>イチネン製作所<br/>ウイングビジョン<br/>オムロン<br/>カールツァイス<br/>化研テック<br/>川崎重工工業<br/>Gichobizビジネスコミュニケーションズ<br/>Cominix<br/>サキコーポレーション<br/>サヤカ<br/>CKD<br/>JUKI<br/>ジュッツジャパン<br/>昭立電気工業<br/>シニアパックス<br/>太平洋電機産業<br/>日本スベリア社<br/>日本ミルテック<br/>日本ロボット工業会 (JARA)<br/>博衆精工<br/>バスコン<br/>白光<br/>パナソニック コネクト<br/>FUJI<br/>武蔵エンジニアリング<br/>ヤマハ発動機<br/>ユニテック</p> | <p><b>SDGsデバイス展</b><br/>産業タイムズ社</p> <p><b>WIRE Japan Show</b><br/>工業通信<br/>ミカドテクノス</p> <p><b>JEP/TEP Show</b><br/>アル電子<br/>飯田通商<br/>NNP<br/>岡本無線電機<br/>三共社<br/>成電社<br/>全国電子部品流通連合会 (JEP)<br/>大和無線電機<br/>ツルタ制御機器<br/>東亜無線電機<br/>東京都電機卸商業協同組合 (TEP)</p> <p><b>E-Textile</b><br/>織研新聞社<br/>米澤物産</p> | <p><b>Smart Sensing</b><br/>アール・ティエ・シー<br/>アイ・アール・システム<br/>YITOAマイクロテクノロジー<br/>イノベーションリサーチ<br/>SMK<br/>エヌエスティ・グローバル<br/>NTTアドバンステクノロジー<br/>ガゾウ<br/>金沢大学振動発電研究室<br/>ケイエルブイ<br/>光波<br/>神戸デジタル・ラボ<br/>コンズ テクノロジー<br/>コネクテックジャパン<br/>産業技術総合研究所<br/>情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会<br/>センサーズ・アンド・ワークス<br/>ソフトエージェンシー<br/>タッチエンス<br/>DIC<br/>帝国インキ製造<br/>デルタツウリン<br/>東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室<br/>東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター<br/>東洋紡<br/>サキコーポレーション<br/>ナノシード<br/>ナルコム<br/>ピクシダステックノロジーズ<br/>富士通<br/>フジック<br/>ポールウェーブ<br/>ホルトプラン<br/>マイクロモジュールテクノロジー<br/>マクセル<br/>MODE, Inc.<br/>リコー<br/>ロボティック普及促進センター</p> | <p><b>All about Photonics</b><br/>InterOpto/LED Japan/Imaging Japan<br/>アイ・アール・システム<br/>アイオーコア<br/>アドコム・メディア<br/>アンシス・ジャパン (旧 Zemax Japan)<br/>エム<br/>応用物理学会 フォトリソ分科会<br/>オプトロニクス社<br/>Caeleste cv<br/>京都光技術研究会<br/>クラビトン<br/>湖北工業<br/>シナジーオプトシステムズ<br/>スペースフォトン<br/>スペクトルデザイン<br/>住友電気工業<br/>ゼータ・ブリッジ<br/>大平貿易<br/>千歳市 / 公立千歳科学技術大学<br/>テラヘルツテクノロジーフォーラム<br/>長岡技術科学大学 電磁波・光波制御研究グループ<br/>日進機械<br/>光産業技術振興協会 (OITDA)<br/>光産業創成大学院大学<br/>光電子融合基盤技術研究所<br/>光バスコミュニケーションズ<br/>フォトテックニカ<br/>物質・材料研究機構<br/>プリントエレクトロニクスグループ<br/>堀場製作所<br/>丸文<br/>三ツ波<br/>理化学研究所<br/>レーザー輸入振興協会<br/>レーザ協会<br/>Laser Focus World Japan<br/>レスターコミュニケーションズ<br/>ロセッタ</p> <p><b>Edge Computing</b><br/>アストロン</p> |
|---|--|--|---|---|--|---|--|